

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

昭63-147861

⑬ Int. Cl.<sup>4</sup>

H 05 K 1/02

識別記号

庁内整理番号

A-6412-5F  
C-6412-5F

⑭ 公開 昭和63年(1988)9月29日

審査請求 未請求 (全2頁)

⑮ 考案の名称 印刷配線基板

⑯ 実 願 昭62-40066

⑰ 出 願 昭62(1987)3月20日

⑱ 考 案 者 金 丸 雄 一 東京都港区南麻布5丁目10番27号 アンリツ株式会社内

⑲ 出 願 人 アンリツ株式会社 東京都港区南麻布5丁目10番27号

⑳ 代 理 人 弁理士 西村 教光

㉑ 実用新案登録請求の範囲

チップ部品3が実装される印刷配線基板1において、

該印刷配線基板1の一部に印刷配線基板1の断面積の小さな柔構造部2を形成し、チップ部品3が実装される実装部1bと、シヤーンに取り付けられる取付部1aとを前記柔構造部2を境として分離し、

前記チップ部品3実装後の実装部1bへの振動、衝撃、熱等による歪を前記柔構造部2によって吸収することを特徴とする印刷配線基板。

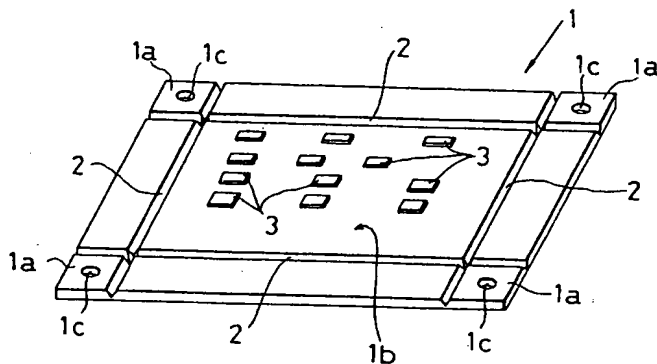
図面の簡単な説明

第1図は、本考案による印刷配線基板の一実施

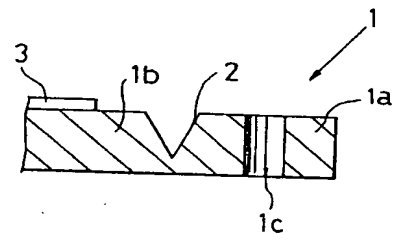
例を示す斜視図、第2図は、同印刷配線基板の柔構造部の部分拡大断面図、第3図は、本考案による印刷配線基板の他の実施例を示す斜視図、第4図及び第5図は各々、本考案による印刷配線基板さらに他の実施例を示す斜視図、第6図は、同印刷配線基板の柔構造部の他の例を示す部分拡大断面図である。

1……印刷配線基板、1a……取付部、1b……実装部、1c……穴、2……柔構造部、3……チップ部品。

第1図

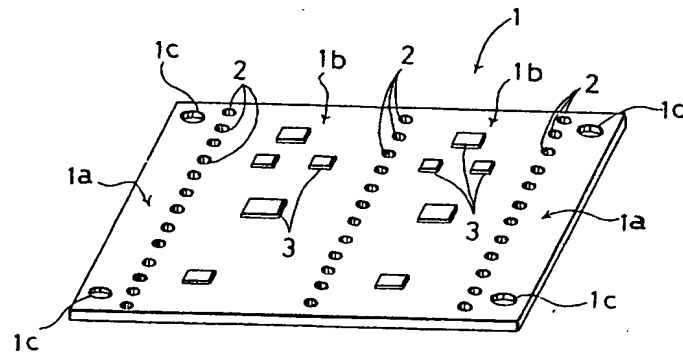


第2図

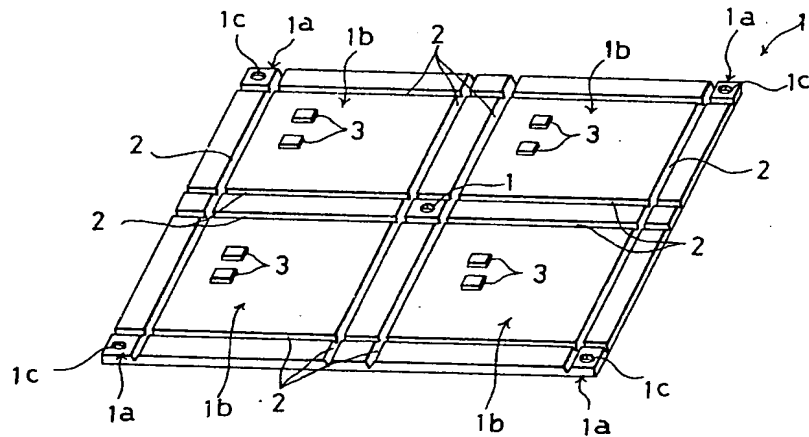


実開 昭63-147861(2)

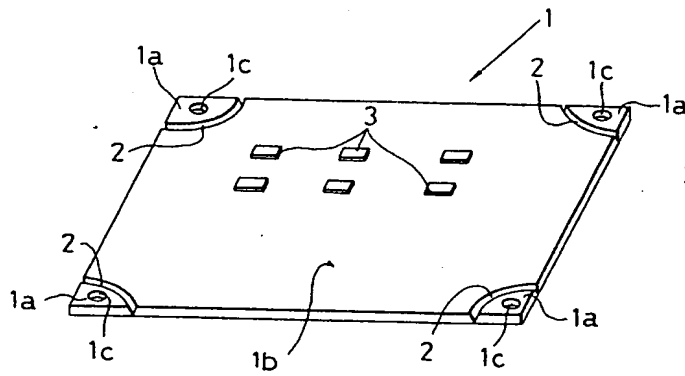
第3図



第4図



第5図



第6図

